# 附件2

# 2022年度高新区集成电路产业发展扶持资金第二批申报书

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 | *（填写名称并加盖单位公章）* | | | |
| 申报项目名称 |  | | | |
| 申报方向 | □ 支持企业加快发展（专题1）  □ 支持产业链上下游联动发展（专题2）  □ 保障产业发展空间（专题3）  □ 支持重大产业项目落户（专题4）  □ 支持产业创新环境发展（专题5） | | | |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 手机 |  |
| 邮箱 |  | 传真 |  |
| 申报单位  联系人 | 姓名 |  | 手机 |  |
| 邮箱 |  | 传真 |  |

珠海高新技术产业开发区科技创新和产业发展局

二〇二二年制

项目申报表

一、单位情况（必填）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.申报单位基本情况** | | | | | | |
| 单位名称（盖章） |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | |  | | | |
| 注册日期 |  | | 注册资本（万元） | |  | |
| 开户银行 |  | | 银行账号 | |  | |
| 单位资质 | □ISO9000系列认证 □ISO14000认证  □ISO27001认证 □ISO20000认证  □CMM系列认证 □ITIL  □GMP认证 □UL认证  □高新技术企业 □其他 | | | | | |
| 单位简介 | *（包括但不限于组织架构，主营业务，主要技术产品，行业排名或竞争力/市场占有率，近年来收入、利润等财务状况，500字内）* | | | | | |
| 业务简介 | *（包括但不限于主营业务所占比重和现状，企业综合能力等，500字内）* | | | | | |
| **3.近三年获得各级政府资助情况** | | | | | | |
| 获财政资金扶持项目 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *序号* | *专项名称* | *项目* | *资助*  *形式* | *验收*  *情况* | *备注* | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   备注  资助形式：配套资金、直接补助、事后奖补  验收情况：到期已验收、到期未验收、未到期在建、事后奖补无需验收  *（如有，2019年至今主承担政府项目名称及验收情况，如未验收请注明项目到期时间）* | | | |
| **3.单位人员总体情况** | | | | | | |
| 2021年员工总人数 | |  | | 研发人员数量 | |  |
| 研发人员占员工总数比例 | | | |  | | |

二、单位财务情况（单位：万元）（必填）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 企业类别 | 主营业务收入 | 集成电路相关收入占比（%） | 税收  （实际缴纳） | 利润 | 研发费用 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 企业类别：集成电路设计企业、集成电路制造企业、集成电路封装测试企业、集成电路设备企业、集成电路材料企业、科研单位、服务平台、创新载体 | | | | | | |

三、申报项目基本信息（单位：人民币：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专题1 支持企业加快发展** | | | | | | | | | | | | |
| 申报单位类型 | □ 规上设计研发类企业  □ 规上制造、封装测试、设备及材料企业 | | | | | | | | | | | |
| 2021年主营业务收入同比2020年增速（%） | | | | | |  | | | | | | |
| 申请补贴金额 | | | | | |  | | | | | | |
| **专题2 支持产业链上下游联动发展** | | | | | | | | | | | | |
| 具体申报方向 | □ 2.1采购芯片或模组补贴  □ 2.2封装补贴 | | | | | | | | | | | |
| 采购芯片或模组名称 | | （2.1填写） | | | | 产品工艺 | | | | | （2.1填写） | |
| 2021年度采购金额 | | （2.1填写）（不含税） | | | | 申请补贴金额 | | | | | （不含税） | |
| 2021年度封装费用金额 | | （2.2填写）（不含税） | | | | 申请补贴金额 | | | | | （不含税） | |
| 项目基本情况 | （包括但不限于采购芯片或模组简介；封装技术简介等，1000字内） | | | | | | | | | | | |
| **专题3 保障产业发展空间** | | | | | | | | | | | | |
| 具体申报方向 | □ 3.1租房补贴支持  □ 3.2购房补贴支持  □ 3.3净化车间装修补贴支持 | | | | | | | | | | | |
| 租赁合同首签日期 | （3.1填写） | | | 租赁场地面积 | | | | | （3.1填写） | | | |
| 租金补贴范围  （3.1填写） | □ 第1-12个月（含）  □ 第13-36个月（含） | | | | | | | | | | | |
| 2021年度符合条件租赁金额（不含税，3.1填写） | （第1-12个月） | | | | | | 申请补贴金额 | | | | | （不含税） |
| （第13-36个月） | | | | | | 申请补贴金额 | | | | | （不含税） |
| 2021年度是否已获得其他房租补贴 | □ 是 | | | | | | （已享受房租补贴费用） | | | | | |
| □ 否 | | | | | | / | | | | | |
| 购房协议日期 | （3.2填写） | | | 完成首付款日期 | | | | | （3.2填写） | | | |
| 实际购置金额 | （不含税） | | | 申请补贴金额 | | | | | （不含税） | | | |
| 净化车间面积 | （3.3填写） | | | | | | 申请补贴金额 | | （不含税） | | | |
| 净化车间洁净等级 | （3.3填写） | | | | | | | | | | | |
| 净化车间认定时间 | （3.3填写） | | 认定机构 | | | | | （3.3填写） | | | | |
| 净化车间地址 | （3.3填写） | | | | | | | | | | | |
| **专题4 支持重大产业项目落户** | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 |  | | | | | | | | | | | |
| 项目总投资额 |  | | | | | | | | | | | |
| 实际募集  到位资金 | （截止到本项目专题申报时） | | | | | | | | | | | |
| 非购地项目 | 实际投入费用 | | | | （截止到本项目专题申报时） | | | | | | | |
| □ 实际投入比例不低于20%  □ 实际投入比例不低于50%  □ 实际投入比例不低于80% | | | | | | | | | | | |
| 购地项目 | □ 已获得施工许可并正式开工  □ 已实现竣工验收并如期按计划进行  □ 已实际投产运营并实现销售收入 | | | | | | | | | | | |
| 申请补贴金额 |  | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | *（1000字内）* | | | | | | | | | | | |
| **专题5 支持产业创新环境发展** | | | | | | | | | | | | |
| 具体申报方向 | □ 5.1支持公共服务平台建设  □ 5.2支持社会组织举办产业活动  □ 5.3鼓励企业参展 | | | | | | | | | | | |
| 平台简介 | （包括但不限于为区内集成电路企业提供软硬件技术支持服务简介等，500字内）（5.1填写） | | | | | | | | | | | |
| 办公场地面积 | （5.1填写） | | | 申请补贴金额 | | | | | | （5.1填写） | | |
| 2021年度举办产业活动场数 | （5.2填写） | | | | | | | | | | | |
| 活动简介 | （5.2填写）*（500字内）* | | | | | | | | | | | |
| 2021年度展会实际发生费用金额 | （5.3填写）（不含税） | | | | | | | | | | | |
| 展会情况简介 | （5.3填写）*（500字内）* | | | | | | | | | | | |

四、审查意见

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位意见 | 情况属实，同意申报。  法定代表人（签字）：  单位盖章：  年 月 日 |
| 区主管部门意见 | □ 同意受理  □ 不予受理  盖章：  年 月 日 |

五、项目附件材料*（对照申报指南提供相关附件，无关附件请删除）*

|  |
| --- |
| □ 1.统一社会信用代码证  □ 2.法定代表人身份证复印件  □ 3.2020年、2021年年度财务审计报告  □ 4.2021年度集成电路收入情况说明（专题1、专题2、专题3、专题4、专题5.3）  □ 5.2020、2021年度所得税纳税申报表主表（专题1）  □ 6.2020、2021年度主营业务收入同比增速情况表（专题1）  □ 7.纳入高新区规上企业情况说明（专题1、专题2和专题3.2）  □ 8.项目专项审计报告（专题2、专题4非购地项目）  □ 9.2021年1月至12月期间实际发生费用明细表，对应合同、发票及付款凭证等佐证材料（超链接版）（专题2）  □ 10.采购的芯片或模组相关知识产权证明材料（专题2.1）  □ 11.采购/服务双方为非关联交易方说明及必要佐证材料（专题2）  □ 12.2021年1月至12月期间实际发生租赁费用明细表，租房协议、发票及付款凭证等佐证材料（超链接版）（专题3.1）  □ 13.实缴注册资本证明材料或2021年度获得投资机构进行投资的集成电路产业化项目说明（申请租金补贴周期为第1-12个月（含）企业提供）（专题3.1）  □ 14.获得专业投资机构（含我区天使投资基金）投资300万元（含）以上、获得国家科技部主办的中国创新创业大赛市赛优胜奖（含）以上、有效的国家高新技术企业认定、完成一次流片佐证资料或纳入高新区规上企业情况说明（申请租金补贴周期为第13-36个月（含）企业提供）（专题3.1）  □ 15.租房补贴承诺函（专题3.1）  □ 16.2021年1月1日至2021年12月31日完成首付款支付的费用明细表、购房协议、发票、付款凭证、房产证、契税凭证等佐证材料（超链接版）（专题3.2）  □ 17.购房补贴承诺函（专题3.2）  □ 18.按净化车间标准装修且达到10万级（含）以上洁净等级标准相关佐证（专题3.3）  □ 19.符合条件的净化车间有效的场地购买证明材料或租赁合同、净化车间面积、施工许可相关佐证（专题3.3）  □ 20.申报单位在境内外证券交易所发行上市相关佐证（专题4）  □ 21.项目可行性实施报告（专题4）  □ 22.项目在境内外资本市场通过配股、增发、发行公司债等方式成功再融资的相关佐证材料（如证监会注册批复、募资发布上市公告、专项资金验资报告等）（专题4）  □ 23.项目备案书  □ 24.非购地项目：截止到本项目专题申报时募集资金实际发生费用专项报告（专题4）  □ 25.购地项目按已实施阶段提供：截止到本项目专题申报时获施工许可并正式开工相关证明材料、实现竣工并验收证明材料、已实际投产且实现销售收入明细表及相关证明材料（专题4）  □ 26.集成电路公共服务平台经国家、省、市、区等相关部门（其中一个）认定备案相关佐证（专题5.1）  □ 27.平台为市财政资金资助建设的佐证材料（专题5.1）  □ 28.为区内集成电路企业提供软硬件技术支持服务相关佐证（专题5.1）  □ 29.有效的场地购买证明材料或租赁合同、发票、付款凭证等佐证（专题5.1）  □ 30.经区科技产业主管部门备案认定相关佐证（专题5.2）  □ 31.2021年度举办产业活动备案证明文件及活动过程、参会单位和参与人数相关佐证文件（专题5.2）  □ 32.2021年1月至12月期间参展证明、实际发生费用明细表及相关佐证（专题5.3）  □ 33.组织参展单位经区科技产业主管部门备案认定相关佐证（专题5.3）  □ 34.参展的展会参展前向区科技产业主管部门备案的佐证（专题5.3）  □ 35.项目绩效目标表  □ 36.申报单位承诺函  □ 37.信用承诺书  □ 38.其它相关证明材料 |